

BD700R

High Speed Burn-in
Board Handler

特 長 — Features —

高速ハンドリング

・UPH6,000以上

稼働率向上

・ツインボードローダー搭載

ランニングコスト低減

・画像アライメント搭載

ダスト対策

・ソケットクリーニング機構 標準搭載



Specification

Device Stocker	JEDEC Tray ※その他形態については別途ご相談下さい。	Power	1Φ 200.0V 3KVA
IC Type	TSOP, QFP, BGA, LGA, QFN, CSP	Air Source	0.5~1.0M Pa
Dimension	1,700(D) x 2,300(W) x 2,100(H) mm 2,300KGS	Burn-In Board	450(W) x 570(L) mm
Throughput	6,000 UPH	NG IC Sorting Function	Installed
Handling Speed	0.45 sec / IC		
Alignment	Optical Alignment		